

## **Mikrobearbeitung von glasfaserverstärkten, flexiblen und nanobeschichteten Leiterplatten mittels Ultrakurzpuls laser.**

Oldorf, P., Peters, R., Bonk, S. M., Gimsa, J., 2014. In Elektronische Baugruppen und Leiterplatten, DVS Media. ISBN 3871555738. 7. DVS/GMM-Tagung EBL 2014, 11.-12. February. Düsseldorf, Germany.

**Abstract:** *Aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften haben Ultrakurzpuls laser (UKP) in der letzten Zeit eine hohe Bedeutung in der Mikromaterialbearbeitung gewonnen. Während die ersten Serienanwendungen dieses Lasertyps vor allem in der Photovoltaik oder beim Schneiden von gehärtetem Glas für Display-Panels in der Unterhaltungselektronik zu finden waren, ergibt sich heutzutage ein breites Applikationsfeld vom Automobilbau, über die Biomedizinische Technik bis hin zur LED- und Halbleiterindustrie, welches die Ultrakurzpuls technologie zu einem der am schnellsten wachsenden Bereiche in der Lasertechnik macht. An dieser Stelle sollen Ergebnisse der Mikrostrukturierung von nanobeschichteten Leiterplatten für die Biosystemtechnik sowie die Bearbeitung von glasfaserverstärkten und flexiblen Leiterplatten aus Polyimid mittels ultrakurzer Laserpulse vorgestellt werden.*

Universität  
Rostock



Traditio et Innovatio